DERWENT-ACC-NO: 2002-530985

DERWENT-WEEK: 200301

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Electron emitting element drive

method involves applying

AC pulse voltage to electrodes for

sufficient period

· •

before applying positive pulse

voltage for drive

INVENTOR: KAWADE, H

PATENT-ASSIGNEE: CANON KK[CANO]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0048790 (February 25, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

US 6490433 B1 December 3, 2002 N/A

000 H01J 009/02

JP 2000311596 A November 7, 2000 N/A

014 H01J 009/02

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

US 6490433B1 N/A

2000US-0512033 February 24, 2000

JP2000311596A N/A

2000JP-0042532 February 21, 2000

INT-CL (IPC): H01J009/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000311596A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - AC pulse voltage having amplitude (Vmax,-Vmax) is applied to the electrodes before applying positive pulse voltage having

peak lesser than Vmax

and more than the electron threshold voltage for drive. The preliminary drive positive voltage is applied for period more than 500 mu sec and the drive voltage is applied for period lesser than 60 mu sec.

USE - For electron emitting element.

ADVANTAGE - By applying preliminary drive voltage and drive voltage for sufficient periods, emission current can be stabilized.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: ELECTRON EMIT ELEMENT DRIVE METHOD APPLY AC PULSE VOLTAGE

ELECTRODE SUFFICIENT PERIOD APPLY POSITIVE PULSE VOLTAGE DRIVE

DERWENT-CLASS: U22 V05

EPI-CODES: U22-E; V05-A01C5;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2002-420453

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-311596 (P2000-311596A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) IntCL'

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01J 9/02

H01J 9/02

審査請求 未請求 請求項の数21 OL (全 14 頁)

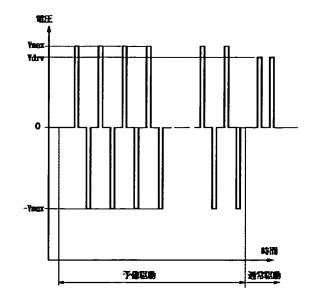
(21)出顧番号	特爾2000-42532(P2000-42532)	(71)出廣人	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出鎮日	平成12年2月21日(2000.2.21)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	河出 一佐哲
(31)優先権主張番号	特顯平11-48790		東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ
(32) 優先日	平成11年2月25日(1999.2.25)		ン株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人	100086287
			弁理士 伊東 哲也 (外1名)

(54) 【発明の名称】 電子放出素子の製造方法および装置、電子放出素子の駆動方法ならびに電子放出素子の調整方法

(57)【要約】

【課題】 電子放出特性を安定化させる。

【解決手段】 電子放出特性を安定化するために、高真 空化で通常駆動時の電圧と同じ極性の電圧と、逆極性の 電圧とを印加する。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも2つの電極を有しており、該2つの電極間に電圧を印加することで電子を放出する電子放出素子の製造方法であって、

1

前記電子放出素子を構成する2つの電極間に電圧を印加する電圧印加工程を有しており、該電圧印加工程において、通常の駆動時に印加する電圧と同極性の電圧である同極性電圧の印加と、通常の駆動時に印加する電圧と逆極性の電圧である逆極性電圧の印加とを行うことを特徴とする電子放出素子の製造方法。

【請求項2】 前記同極性電圧の大きさが、前記通常の 駆動時に印加する電圧の大きさよりも大きい請求項1に 記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項3】 前記逆極性電圧の大きさが、前記通常の 駆動時に印加する電圧の大きさよりも大きい請求項1に 記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項4】 前記逆極性電圧の大きさが、前記同極性 電圧の大きさよりも小さい請求項1乃至3いずれかに記 載の電子放出素子の製造方法。

【請求項5】 前記電圧印加工程は、高真空雰囲気で行う請求項1乃至4いずれかに記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項6】 前記電圧印加工程は、雰囲気中の炭素および炭素化合物の分圧が1×10-6Pa以下の雰囲気で行う請求項1乃至5いずれかに記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項7】 前記2つの電極は間に間瞭部を有している請求項1乃至6いずれかに記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項8】 前記間隙部は炭素もしくは炭素化合物を有する請求項7に記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項9】 前記電圧印加工程に先立ち、間に間除部を有する前記2つの電極を形成する工程を有する請求項 1乃至8いずれかに記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項10】 前記電圧印加工程に先立ち、堆積物が 堆積された間隙部を間に有する前記2つの電極を形成す る工程を有する請求項1乃至9いずれかに記載の電子放 出素子の製造方法。

【請求項11】 前記電圧印加工程は、該電圧印加工程 において前記2つの電極の間の間隙部が雰囲気中の物質 もしくは雰囲気中の物質に基づく物質の堆積により狭く ならない雰囲気で行う請求項7乃至10いずれかに記載 の電子放出素子の製造方法。

【請求項12】 前記電圧印加工程は、通常の駆動時と ほぼ同様の雰囲気で行う請求項1乃至11いずれかに記 載の電子放出紫子の製造方法。

【請求項13】 前記電圧印加工程における電圧の印加は、バルス電圧の印加である請求項1乃至12いずれか記載の電子放出案子の製造方法。

【請求項14】 前記電圧印加工程において、前記パル

ス電圧を複数回印加する請求項13に記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項15】前記電圧印加工程においては、バルス 状の前記同極性電圧の印加と、バルス状の前記逆極性電 圧の印加とを交互に行う請求項1乃至14いずれかに記 載の電子放出素子の製造方法。

【請求項16】 前記電圧印加工程における、前記正極 性電圧の印加時間の合計は500μsec以上である請 求項1乃至15いずれかに記載の電子放出素子の製造方 10 法。

【請求項17】 前記電圧印加工程における、前記正極性電圧の印加時間の合計は60sec以下である請求項1乃至16いずれかに記載の電子放出素子の製造方法。 【請求項18】 前記電圧印加工程における、前記逆極性電圧の印加時間の合計は前記正極性電圧の印加時間の合計以下である請求項1乃至17いずれかに記載の電子放出素子の製造方法。

【請求項19】 請求項1乃至18いずれかに記載の電子放出素子の製造方法において用いる電子放出素子の製造方法において用いる電子放出素子の製造装置であって、前記2つの電極の間に電圧を印加するための電位出力部を有している電子放出素子の製造装置。

【請求項20】 少なくとも2つの電極を有しており、 該2つの電極間に電圧を印加することで電子を放出する 電子放出素子の駆動方法であって、

前記電子放出素子は、前記電子放出素子を構成する2つの電極間に互いに極性の異なる電圧をそれぞれ印加する 電圧印加工程を経て製造もしくは調整されたものであ り、

30 駆動時には、前記互いに異なる極性のうちの一方の極性 の電圧を前記2つの電極間に印加して通常の駆動を行う ことを特徴とする電子放出素子の駆動方法。

【請求項21】 少なくとも2つの電極を有しており、 該2つの電極間に電圧を印加することで電子を放出する 電子放出素子の調整方法であって、

前記電子放出素子を構成する2つの電極間に電圧を印加する電圧印加工程を有しており、該電圧印加工程において、通常の駆動時に印加する電圧と同極性の電圧である同極性電圧の印加と、通常の駆動時に印加する電圧と逆極性の電圧である逆極性電圧の印加とを行うことを特徴とする電子放出素子の調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子放出素子の製造方法および装置、電子放出素子の駆動方法、ならびに電子放出素子の調整方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子放出素子としては大別して熱電子放出素子と冷陰極電子放出素子を用いた2種類のも50 のが知られている。冷陰極電子放出素子には電界放出型

(以下、「FE型」という。)、金属/絶縁層/金属型 (以下、「MIM型」という。)、表面伝導型等があ る。FE型の例としてはW. P. Dyke&W. W. D olan, "Field emission", Adv ance in Electron Physics, 8, 89 (1956), C. A. Spindt, "PH YSICAL Properties of thin -film field emission cath odes with molybdenium con es", J. Appl. Phys., 47, 5248 (1976)等に開示されたものが知られている。MI M型の例としてはC. A. Mead, "Operati on of Tunnel-Emission Dev ices", J. Apply. Phys., 32, 64 6 (1961) 等に開示されたものが知られている。表 面伝導型電子放出素子の例としては、M. I. Elin son, Radio Eng. Electron Ph ys., 10, 1290, (1965) 等に開示された ものがある。

【0003】表面伝導型電子放出素子は、基板上に形成 20 された小面積の薄膜に、膜面に平行に電流を流すことにより電子放出が生ずる現象を利用するものである。この表面伝導型電子放出素子としては、前記エリンソン等によるSnO2薄膜を用いたもの[M. I. Elinson, Radio Eng. Electron Phys., 10, 1290, (1965)]、Au薄膜によるもの[G. Dittmer, "Thin Solid Films", 9, 317 (1972)]、In2O3/SnO2薄膜によるもの[M. Hartwell and C. G. Fonstad, "IEEE Tran 30s. ED Conf.", 519 (1975)]、カーボン薄膜によるもの[荒木久 他:真空、第26巻、第1号、22頁(1983)]等が報告されている。

【0004】上述のFE型、MIM型、表面伝導型等の 電子放出素子は、基板上に多数素子を配列形成できる利 点があり、これらを応用した様々な画像表示装置の提案 がなされている。

【0005】基板上に形成された小面積の導電性薄膜に、膜面に平行に電流を流すことにより、導電性薄膜内に形成された電子放出部より電子を放出する表面伝導型 40電子放出素子は、構造が単純で製造も容易であることから、大面積にわたり多数の素子を形成することができ、例えば画像表示装置等への応用が研究されている。表面伝導型電子放出素子を画像表示装置に応用した例としては、本出願人によるUSP5、066、883や特開平6-342636号公報等が挙げられる。これらの公報では、基板上に設けられた一対の素子電極と、これら索子電極対に接続する導伝膜と、導伝膜内に形成した電子放出部とからなる表面伝導型電子放出素子を2次元的に複数配置し、それぞれの電子放出素子から放出される故 50

出電子を個別に選択するように電気的な選択手段を設 け、入力信号に応じて画像を形成する手段および製造方 法が記載されている。また、本出願人による特開平7-235255号公報では、有機物の存在下において表面 伝導型電子放出素子に電圧を印加する等により、電子放 出部近傍に炭素を主成分とする堆積物を形成し、表面伝 導型電子放出素子の電子放出特性を向上させるための手 法が開示されている。また、本出願人による特開平7-235275号公報では、電子放出素子が形成された環 10 境における有機物の残留分圧を、1.3×10-6 Pa以 下にするなどの手段により、電子放出特性を安定化する 手法が開示されている。また、本出願人による特開平9 -259753号公報では、2次元的に複数配置したそ れぞれの表面伝導型電子放出素子に対し、有機ガスの分 圧が1.3×10-6Pa以下の雰囲気中で、予め通常の 駆動電圧の最大値と、表面伝導型電子放出素子に入り得 るノイズ電圧とを加算した電圧よりも高い電圧パルスを 印加することで、通常駆動時の駆動回路の温度特性や外 乱によって発生する放出電流の不可逆的な不安定性を抑

4

【0006】上述の手法を応用して作成される表面伝導 型電子放出素子を用いた画像表示装置は、従来の他の方 式の画像表示装置よりも優れた特性が期待されている。 例えば、近年普及してきた液晶表示装置と比較しても、 自発光型であるためにバックライトを必要としない点 や、視野角が広いといった点が優れている。

制し、輝度むらを低減する手法が開示されている。

【0007】上述したように、表面伝導型電子放出素子は構造が単純で製造も容易であり、また、優れた電子放出特性を有するため、画像形成部材として蛍光体を用いた画像形成装置、例えば、大型の自発光型フラットディスプレイを構成するのに好適な電子放出素子である。また、電子源を利用した、各種分析装置、加工装置等への応用も期待される。このように、画像形成装置等への応用を考慮すると、電子放出素子に対しては、期待される電子ビーム量を安定して放出し続けることが求められる。さらに信頼性の高い画像形成装置や分析装置等を提供するためには、従来の電子放出素子に対し、さらに安定した電子放出特性を付与することが求められている。【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、好適な電子 放出素子を製造できる製造方法、好適な電子放出素子の 製造装置、好適な電子放出素子の駆動方法、および好適 な電子放出素子の調整方法を実現することを課題とす る。特には、電子放出素子において、安定した電子放出 特性を実現することを課題とする。

[0009]

では、基板上に設けられた一対の素子電極と、これら素 子電極対に接続する導伝膜と、導伝膜内に形成した電子 放出部とからなる表面伝導型電子放出素子を2次元的に 複数配置し、それぞれの電子放出素子から放出される放 50 有しており、該2つの電極間に電圧を印加することで電 20

子を放出する電子放出素子の製造方法であって、前記電 子放出素子を構成する2つの電極間に電圧を印加する電 圧印加工程を有しており、該電圧印加工程において、通 常の駆動時に印加する電圧と同極性(以下、正極性とも いう) の電圧である同極性電圧の印加と、通常の駆動時 に印加する電圧と逆極性の電圧である逆極性電圧の印加 とを行うことを特徴とする電子放出素子の製造方法、で ある。

【0010】ここで、前記同極性電圧の大きさが、前記 適であり、また、前記逆極性電圧の大きさが、前記通常 の駆動時に印加する電圧の大きさよりも大きいと好適で あり、また、前記逆極性電圧の大きさが、前記同極性電 圧の大きさよりも小さいと好適である。

【0011】また、前記電圧印加工程は、高真空雰囲気 で行うと好適である。また、前記2つの電極はそれらの 間に間隙部を有するものである場合、前記電圧印加工程 は、該電圧印加工程において前記2つの電極の間の間隙 部が雰囲気中の物質もしくは雰囲気中の物質に基づく物 質の堆積により狭くならない雰囲気で行うと好適であ る。また、前記電圧印加工程は、雰囲気中の炭素および 炭素化合物の分圧が1×10-6Pa以下の雰囲気で行う と好適である。また、前記電圧印加工程は、通常の駆動 時とほぼ同様の雰囲気で行うと好適である。また、前記 電圧印加工程に先立ち、間に間隙部を有する前記2つの 電極を形成する工程を有する場合に本発明は特に好適に 採用できる。

【0012】なお、本発明による電子放出素子の製造方 法は、特に冷陰極素子の製造方法として好適に採用でき る。特には、電界放出型の電子放出素子や、表面伝導型 30 の電子放出素子や、2つの電極間に絶縁層を挟んだ構成 のMIM型の電子放出素子の製造方法として好適に採用 できる。特には、2つの電極の間に間隙部を有する電子 放出素子の製造方法として好適に採用できる。例えばス ピント型の電界放出型電子放出素子においては、エミッ タコーン電極とゲート電極が間に間隙を有する2つの電 極となる。表面伝導型の電子放出素子の場合は、高電位 側電極と低電位側電極が間に間隙を有する2つの電極と なる。一対の素子電極と該一対の素子電極の間に導電性 膜を有している表面伝導型の電子放出素子においては、 該導電性膜が有する間隙が前記間隙部となる。

【0013】例えば表面伝導型の電子放出素子において は、2つの電極の間の間隙部に炭素もしくは炭素化合物 を堆積させる活性化といわれる工程を製造時に行う技術 が知られている。該活性化を行うことにより、堆積物が 堆積された間隙部を間に有する2つの電極を構成するこ とができる。本発明は電極間の間瞭部がそのような堆積 物を有する構成に特に好適に適用することができる。堆 積物を堆積させる際に、雰囲気が含む物質もしくは雰囲 気が含む物質に由来する物質を堆積させる堆積工程を用 50

いている場合は、本発明の電圧印加工程は、堆積工程の 後、堆積物となる物質の分圧を低くしてから行うとよ 12

【0014】また、本発明において、前記電圧印加工程 における電圧の印加は、パルス電圧の印加であると好適 であり、該パルス電圧を複数回印加する構成が好適に採 用できる。また、本発明において、前記電圧印加工程で は、パルス状の前記同極性電圧の印加と、パルス状の前 記逆極性電圧の印加とを交互に行うと好適である。ま 通常の駆動時に印加する電圧の大きさよりも大きいと好 10 た、該交互の電圧印加を複数回繰り返す構成を好適に採 用できる。

> 【0015】また、本発明において、前記電圧印加工程 における、前記正極性電圧の印加時間の合計は500_年 sec以上、および/ または、60sec以下であると よい。また、前記電圧印加工程における、前記逆極性電 圧の印加時間の合計は前記正極性電圧の印加時間の合計 以下であるとよい。ここで、電圧の印加時間の合計と は、パルス電圧の印加である場合は各パルスの印加時間 の合計である。

> 【0016】また、本発明は、上記電子放出素子の製造

方法において用いる製造装置を含んでおり、該製造装置 は、前記2つの電極の間に電圧を印加するための電位出 力部を有している。該電位出力部としては、図6に符号 51で示されるような電源を採用することができる。 【0017】また、本発明は、電子放出素子の駆動方法 の発明を含んでいる。すなわち、少なくとも2つの電極 を有しており、該2つの電極間に電圧を印加することで 電子を放出する電子放出素子の駆動方法であって、前記 電子放出素子は、前記電子放出素子を構成する2つの電 極間に互いに極性の異なる電圧をそれぞれ印加する電圧 印加工程を経て製造もしくは調整されたものであり、駅 動時には、前記互いに異なる極性のうちの一方の極性の 電圧を前記2つの電極間に印加して通常の駆動を行うこ とを特徴とする電子放出素子の駆動方法、である。

【0018】また、本発明は以下の構成の電子放出素子 の調整方法を含んでいる。すなわち、少なくとも2つの 電極を有しており、該2つの電極間に電圧を印加するこ とで電子を放出する電子放出素子の調整方法であって、 前記電子放出素子を構成する2つの電極間に電圧を印加 する電圧印加工程を有しており、該電圧印加工程におい て、通常の駆動時に印加する電圧と同極性の電圧である 同極性電圧の印加と、通常の駆動時に印加する電圧と逆 極性の電圧である逆極性電圧の印加とを行うことを特徴 とする電子放出素子の調整方法、である。

【0019】この調整方法は、製造された電子放出案子 が出荷された後に調整を行う場合に好適に用いることが できる。これら駆動方法および調整方法においても、前 記製造方法として延べたのと同様の条件を採用すること

【0020】本発明によれば、以下に詳述するように、

10

ことができる。

7

放出電流が長期に渡って安定した電子放出素子が提供さ れる。したがって、画像形成装置等の製造または調整に 適用することにより、信頼性の高い画像形成装置等が提 供される。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。まず、本発明の電子放出素子の製造方法の説 明に先立ち、本発明が適用可能な表面伝導型電子放出素 子が有する電気特性について説明する。図2は、本発明 が適用可能な表面伝導型電子放出素子の典型的な構成例 の概略図である。図2(a)は平面型表面伝導型電子放 出素子の平面図、図2(b)は平面型表面伝導型電子放 出素子の断面図、図2(c)は垂直型表面伝導型電子放 出素子の断面図である。図2(a)~(c)中、同一の 符号は同種の構成部材を示す。これらの図において、1 は絶縁性の基板、21は基板1上に設けられた絶縁性の 材料からなる段差形成部、2および3は基板1または段 差形成部21上に設けられた素子電極、4は素子電極2 および3を電気的に連絡した導電性膜、5は導電性膜4 中に形成した間隙部 (電子放出部)である。

【0022】図6は、次に説明する表面伝導型電子放出 素子の電気特性を測定するための測定系を示す概略図で あり、図6中の図2と同一の符号で示したものは、図2 と同一の構成部材を示す。なお、図6に示す装置は、後 述する表面伝導型電子放出素子の製造工程で使用される 場合もある。図6において、54は電子放出部5から放 出した電子を捕捉するためのアノード電極、51は素子 電極2および3間に印加する電圧(以降、素子電圧Vf と呼ぶ)を発生するための電源、50は素子電極2およ び3間を流れる素子電流 Ifを計測するための電流計、 53はアノード電極54に印加する高電圧を発生するた めの高圧電源、52はアノード電極54に流れる放出電 流 I e を計測するための電流計、55は真空槽、57は 真空槽55と真空ボンプ56との間に設けたゲートバル ブである。また、この測定装置を後述する活性化工程で も使用する場合は、活性化物質の収容容器58と、活性 化物質の真空槽への導入量を制御する制御バルブ59を 有する。

【0023】表面伝導型電子放出素子の電気特性は、通 常、放出電流Ieと素子電圧Vfとの関係、ならびに、 素子電流 I fと素子電圧Vfとの関係により代表され る。これらの関係を求めるためには、図6に示すよう に、表面伝導型電子放出素子を真空に排気された環境下 に配置し、素子の2mm~8mm上方にアノード電極を 配置する。そして、アノード電極に対して100V~1 0kV程度の電圧を印加し、索子電極間には素子電圧V fを印加して、このときに流れる衆子電流 Ifと放出電 流Ieを計測する。

【0024】以上のようにして求めた電気特性の代表的

て著しく小さいので、図7ではこれらを任意単位で示し ている。また、縦軸および横軸はともにリニアスケール である。 同図に示されるように、表面伝導型電子放出素 子は、ある電圧(しきい値電圧Vth)以上の素子電圧 Vfを印加すると、急激に放出電流Ieが単調増加し、 また、後述する安定化処理を行った表面伝導型電子放出 素子においては、素子電流 I f も素子電圧V f の増加に 伴い急激に単調増加する。安定化処理とは、後述する活 性化処理時に見られるような、表面伝導型電子放出素子 への通電によって電子放出部やその近傍に更に新たな炭 素もしくは炭素化合物が堆積する現象を抑制するため、 表面伝導型電子放出素子の周辺の空間に存在し、もしく は表面上に吸着している有機ガスの残留量を低減させる 処理である。具体的には、新たな有機ガスの流入がない 状態で、例えば、真空槽ならびに表面伝導型電子放出素

子を加熱しながら真空排気を継続することによって行う

【0025】上述の電気特性について、図7に示した手 法とは異なる表示手法によって表示した例を図8に示 20 す。図8に示すグラフの表現方法は、所謂Fowler -Nordheimプロットと呼ばれる表現方法であ り、電子放出素子から放出される電子が電界放出による ものであるとき、右下がりの直線となる。本発明が適用 可能な表面伝導型電子放出素子の電気特性を、図8のF owler-Nordheimプロットで表現すると、 図8に示すように、放出電流 I e および素子電流 I fに ついて共に右下がりの直線となって表される。なお、素 子電流から求めた直線と、放出電流から求めた直線の傾 きは、ほぼ同じ値となる。 これより、 素子電流 Ifの伝 導機構は電界放出によるものであること、また、A. A saib(SID Intl. Symp. Digest Tech. Papers, 127 (1997)) によ れば、放出電流Ieは素子電流Ifの一部が多重の弾性 散乱を行った後にアノード電極へ到達したものであるか ら、電界放出による素子電流 I f の伝導機構を反映し て、放出電流IeもFowler-Nordheimプ ロットで右下がりの直線として表されるということが言 える。

【0026】素子電流 I fが電界放出によるので、ゆを 電子放出部の仕事関数とすると、素子電流 I f は数 1 式 で表すことができる。

[0027]

$$L = \frac{1.4 \times 10^{-9} \ \alpha \ \beta^{2} V_{i}^{3}}{\phi} \exp \left(\frac{9.9}{\sqrt{\phi}} \right) \exp \left(-\frac{6.5 \times 10^{7} \ \phi}{\beta \ V_{i}} \right)$$

【0028】ここで、 α は電子放出領域であり、 β は電 界換算係数であって、電子放出部近傍の形状を反映する パラメータである。なお、BVfが電界放出を行う領域 な例を図7に示す。放出電流Ieは素子電流Ifに比べ 50 の電界強度に相当する。したがって、仕事関数φの値を

出部近傍の最大電界強度 BVmaxが一定となるよう に、電子放出部近傍の形状が変化し、それが Bの変化と なって現れていることを示している。 【0032】このように、安定化工程後に、それまで経 験したことの無い最大素子電圧Vmaxを初めて経験する時、電子放出部近傍の形状変化を伴う。なお、一度V

験したことの無い最大素子電圧Vmaxを初めて経験する時、電子放出部近傍の形状変化を伴う。なお、一度Vmaxを経験した後、Vmax以下の素子電圧Vfによって駆動を行うと、電界換算係数βの変化はほとんど無く、したがって、電子放出部近傍の形状変化も少ない。また、Vf<Vmaxなる素子電圧で駆動するため、電気放出部近傍に印加される電界強度βVmaxよりも低くなる。

1.0

【0033】一方、電子放出部に炭素ないし炭素化合物の膜を有する冷陰極電子放出素子、とりわけ、表面伝導型電子放出素子において、電子放出部が経験する最大電界強度を維持した状態で駆動を継続すると、強い電界強度の影響で、駆動に伴い電子放出領域αが減少していく。

【0034】本発明の製造方法で行われるように、電子放出素子の駆動を、最大電界強度βVmaxよりも低い電界強度で駆動すると、駆動に伴う放出領域αの減少を抑えることができるため、放出電流Ieを安定させることができる。

【0035】なお、実際に電子放出素子を駆動する際、 駆動用の電圧パルスの印加時にリンギングが発生した り、あるいは外部からのノイズ等により逆極性の電圧が 印加される場合がある。これにより、電子放出部近傍が ダメージを受け、電子放出領域αが減少したりすること によって、上述したメモリ特性を失い、放出電流の減少 や素子の破壊等を引き起こす場合がある。これに対して は、本発明の製造方法において、予め、正極性のパルス 電圧だけでなく、通常の駆動とは逆極性のパルス電圧を 印加しておくようにすれば、ある決まった状態の特性が メモリされる。したがって、上記のような逆極性の電圧 が印加されても、そのメモリ特性に変化が生じることな く、安定な駆動が行われる。

【0036】以下、図1を用いて本発明の製造方法を説明する。図1は、本発明の製造方法の一例において、安定化工程を経た電子放出素子に対して、通常の駆動に先立って印加するパルス状電圧を示す図である。図1に示すように、Vmaxなる波高値をもつ正極性のパルス電圧と、-Vmaxの波高値をもつ逆極性のパルス電圧と、-Vmaxの波高値をもつ逆極性のパルス電圧を1回以上交互に印加し、これを繰り返す。この時点までの電圧パルス印加を総称して、以降、予備駆動と呼ぶ。この予備駆動を行った後、Vmaxよりも低く、かつ電子放出しきい値電圧以上の素子電圧Vdrvの波高値のパルスで駆動を行うことによって、安定して電子放出を行うことができる。なお、Vmaxの値は、表面伝導型電子放出をそのできる。なお、Vmaxの値は、表面伝導型電子放出をそのできる。なお、Vmaxの値は、表面伝導型電子放出をそのできる。なお、Vmaxの値は、表面伝導型電子放出をそのできる。なお、Vmaxの値は、表面伝導型電子放出を発展を表表しています。

指定すれば、図8の直線の傾きとy軸との切片から、放出領域αと電界換算係数βを得ることができる。ここで、電子放出素子を一定の素子電圧Vfで駆動を行うとき、駆動中に仕事関数φと電界換算係数βが変化しないならば、素子電流Ifの変動は放出領域αの変動であるということができる。さらに、放出電流Ieは素子電流Ifの一部であるので、放出電流Ieの変動は放出領域αの変動に起因すると言ってもよい。詳しくは後述するが、本発明の製造方法はこの放出領域αの変動を抑えることによって、放出電流Ieを安定化させる製造方法で10あることも1つの特徴としている。

【0029】次に、本発明が適用可能な表面伝導型電子放出素子が有する別の特性である「メモリ特性」について説明する。「メモリ特性」とは、表面伝導型電子放出素子の電気特性カーブ(放出電流と駆動電圧、ならびに素子電流と駆動電圧の関係)が、それまで経験した印加電圧の最大値よりも大きな電圧を新たに経験すると、異なる特性へとシフトし、以降、さらに大きな駆動電圧を経験するまで、それが維持されるという特性である。メモリ特性は、先述した安定化処理を施した表面伝導型電20子放出素子に顕著に見られる特性である。これを、図9を用いて説明する。

【0030】図9 (a)は、表面伝導型電子放出素子に 印加する素子電圧Vfと、アノード電極によって捕捉さ れる放出電流Ieとの関係を表すグラフである。 グラフ の横軸は素子電圧Vf、縦軸は放出電流Ieの大きさを 表す。図中の電気特性曲線Aは、安定化処理後に初めて 印加される素子電圧の最大値(以降、最大素子電圧Vm axと呼ぶ)がVf1であるときの特性曲線であり、同 様に、特性曲線BはVmaxがVf2(>Vf1)のと 30 き、特性曲線CはVmaxがVf3 (>Vf2) のとき、 の特性曲線である。図で示すように、最大素子電圧Vm axがVf1であるとき、印加電圧がVf1以下であれ ば、経時劣化が無視できる範囲の時間において、素子電 圧Vfと放出電流 Ieの関係は常に特性曲線A上にあ る。ところが、ひとたびVf1以上の最大素子電圧、例 えばVf2を経験させると、特性曲線はBにシフトし、 再びVf1以下の素子電圧を印加しても、放出電流Ie は特性曲線Aで得られたときの値よりも小さな値にな る。さらに大きな最大素子電圧例えばVf3を経験させ 40 ると、特性曲線はCにシフトして、同様の傾向を示す。 なお、素子電流 I fと素子電圧Vfとの関係において も、同様の特性を有している。

【0031】上記特性曲線A、B、Cに対応する素子電 流 I f と素子電圧 V f の関係を F o w l e r - N o r d h e i m プロットで表し、その傾きから、特性曲線A、 B、C それぞれの電界換算係数 β A、 β B、 β C を求める と、 β A > β B > β C であり、さらに、 β A V f $1 = \beta$ B V f $2 = \beta$ C V f 3 という結果が得られる。これはすなわ ち、最大素子電圧 V m a x が大きくなるに伴い、電子放 50 できる。

【0037】予備駆動における波高値Vmaxの正極性パルス電圧で駆動する時間の総和、例えばパルス幅×パルス数は、500μsec以上であることが望ましい。これにより、素子電圧Vdrvによる通常駆動時において放出領域なが安定し、したがって、放出電流Ieが安定する。また、波高値Vmaxで駆動される時間の総和は、60sec以下であることが好ましい。この値以上の時間、Vmaxによる駆動を行うと、予備駆動中に放出領域なが大きく減少し、通常駆動時の放出電流Ieが少なくなってしまうからである。なお、予備駆動中に放出領域なが大きく減少して、通常駆動時の放出電流Ieが少なくなってしまう現象を防ぐためにも、前記逆極性のパルス電圧で印加される各パルスの印加時間の合計が、前記正極性のパルス電圧で印加される各パルスの印加時間の合計以下であることが好ましい。

【0038】また、図1では波高値Vmaxの正極性のパルス電圧と波高値-Vmaxの逆極性のパルス電圧を交互に繰り返し印加しているが、特にこれにこだわることなく、波高値の絶対値が通常駆動時の素子電圧Vdrvより大きくかつVmax以下である逆極性のパルス電 20 圧が予備駆動中に少なくとも1回印加されればよい。例えば、図10に示すように、波高値Vmaxの正極性のパルス電圧を繰り返し印加した後、逆極性のパルス電圧を印加し、再度正極性のパルスを印加するといった方法を採ることもできる。

【0039】以下、本発明が適用可能な表面伝導型電子 放出素子の構成について述べ、その後、本発明の特徴で ある予備駆動工程を備えた電子放出素子の製造方法につ いて具体的に述べる。

【0040】<表面伝導型電子放出素子の構成と製法> 30 図2を用いて本発明が適用可能な表面伝導型電子放出素子について説明する。本発明を適用し得る表面伝導型電子放出素子の基本的構成としては大別して、平面型および垂直型の2つがある。先ず、平面型表面伝導型電子放出素子について説明する。図2(a)および(b)は、本発明が適用可能な平面型表面伝導型電子放出素子の構成を模式的に示す平面図および断面図である。これらの図において、1は基板、2と3は基板1上の素子電極、4は素子電極2と3間に設けられた導電性膜、5は導電性膜4中に形成された電子放出部である。 40

【0041】基板1としては、石英ガラス、Na等の不純物含有量を減少したガラス、ソーダライムガラス、ソーダライムガラスにスパッタ法等により形成したSiOzを積層したガラス基板、アルミナ等のセラミックス、Si基板等を用いることができる。

【0042】対向する素子電極2および3の材料として は一般的な導体材料を用いることができる。例えばN i、Cr、Au、Mo、W、Pt、Ti、Al、Cu、 Pd等の金属あるいは合金、Pd、Ag、Au、RuO 2、Pd-Ag等の金属あるいは金属酸化物とガラス等 から構成されるの印刷導体、In2O3-SnO2等の透明導電体、ポリシリコン等の半導体材料等から適宜選択することができる。素子電極2および3間の間隔し、素子電極2および3の長さW、導電性膜4の形状等は、応用される形態等を考慮して設計される。素子電極間隔しは、好ましくは数百nm~数百μmの範囲とすることができ、より好ましくは、数μm~数十μmの範囲とすることができる。素子電極長さWは、電極の抵抗値、電子放出特性等を考慮して、数μm~数百μmの範囲とすることができる。素子電極2および3の膜厚はは、数十nm~数μmの範囲とすることができる。なお、図2に示した構成だけでなく、基板1上に、導電性膜4、対向する素子電極2および3の順に積層した構成とすることも

12

【0043】 導電性膜4としては、良好な電子放出特性 を得るために、微粒子で構成された微粒子膜を用いるの が好ましい。その膜厚は、素子電極2、3へのステップ カバレージ、素子電極2、3間の抵抗値および後述する フォーミング条件等を考慮して適宜設定されるが、通常 は数百pm~数百nmの範囲とするのが好ましく、より 好ましくは1 nm~50 nmの範囲とするのが良い。そ の抵抗値は、Rsが10²~10⁷Ω/□の値である。な お、Rsは、厚さがt、幅がwで長さがLの薄膜の抵抗 Rを、R=Rs (L/w)とおいたときに現れる量であ る。本明細書において、フォーミング処理については、 通電処理を例に挙げて説明するが、フォーミング処理は これに限られるものではなく、膜に亀裂を生じさせて高 抵抗状態を形成する処理を包含するものである。導電性 膜4を構成する材料は、Pd、Pt、Ru、Ag、A u, Ti, In, Cu, Cr, Fe, Zn, Sn, T a、W、Pd等の金属、PdO、SnO2、In2O3、 PbO、Sb2O3等の酸化物、HfB2、ZrB2、La B6、CeB6、YB4、GdB4等の硼化物、TiC、Z rC、HfC、TaC、SiC、WC等の炭化物、Ti N、ZrN、HfN等の窒化物、Si、Ge等の半導 体、カーボン等の中から適宜選択される。ここで述べる 微粒子膜とは、複数の微粒子が集合した膜であり、その 微細構造は、微粒子が個々に分散配置した状態、あるい は微粒子が互いに隣接または重なり合った状態(いくつ 40 かの微粒子が集合し、全体として島状構造を形成してい る場合も含む)をとっている。微粒子の粒径は、0.1 nmの数倍~数百nmの範囲、好ましくは、1nm~2 0 n mの範囲である。

【0044】電子放出部5は、導電性膜4の一部に形成された高抵抗の亀裂により構成され、導電性膜4の膜厚、膜質、材料および後述する通電フォーミング等の手法等に依存したものとなる。電子放出部5の内部には、0.1 nmの数倍~数十nmの範囲の粒径の導電性微粒子が存在する場合もある。この導電性微粒子は、導電性50 膜4を構成する材料の元素の一部、あるいは全ての元素

を含有するものとなる。電子放出部5およびその近傍の 導電性膜4には、炭素および炭素化合物を有することも できる。

【0045】次に、垂直型表面伝導型電子放出素子につ いて説明する。図2(c)は、本発明の表面伝導型電子 放出素子に使用できる垂直型表面伝導型電子放出素子の 一例を示す模式図である。図2(c)においては、図2 (a) ならび(b) に示した部位と同じ部位には図2 (a) ならび (b) に付した符号と同一の符号を付して いる。21は段差形成部である。基板1、素子電極2お 10 よび3、導電性膜4、電子放出部5は、前述した平面型 表面伝導型電子放出素子の場合と同様の材料で構成する ことができる。段差形成部21は、真空蒸着法、印刷 法、スパッタ法等で形成されたSiOz等の絶縁性材料 で構成することができる。段差形成部21の膜厚は、先 に述べた平面型表面伝導型電子放出素子の素子電極間隔 Lに対応させて、数百nm~数十µmの範囲とすること ができる。この膜厚は、段差形成部21の製法、および 素子電極2、3間に印加する電圧を考慮して設定される が、数十nm~数μmの範囲が好ましい。導電性膜4 は、素子電極2および3と段差形成部21の作成後に、 素子電極2、3の上に積層される。電子放出部5は、図 2(c)においては、段差形成部21に形成されている が、作成条件、フォーミング条件等に依存し、形状、位 置ともこれに限られるものでない。

【0046】上述の表面伝導型電子放出素子の製造方法 としては様々な方法があるが、その一例を図3に模式的 に示す。以下、図2および図3を参照しながら製造方法 の一例について説明する。図3においても、図2に示し た部位と同じ部位には図2に付した符号と同一の符号を 30 付している。

【0047】(1)まず、基板1を洗剤、純水および有機溶剤等を用いて十分に洗浄し、真空蒸着法、スパッタ法等により素子電極材料を堆積させてから、例えばフォトリソグラフィ技術を用いて基板1上に素子電極2および3を形成する(図3(a))。

【0048】(2)次に、素子電極2および3を設けた基板1に、有機金属溶液を塗布して有機金属溶膜を形成する。有機金属溶液には、前述の導電性膜4の材料の金属を主元素とする有機金属化合物の溶液を用いることができる。そして、有機金属溶膜を加熱焼成処理し、例えば導電性膜4の形状に対応したマスクを用いてリフトオフを行う方法や、エッチング等によりパターニングし、導電性膜4を形成する(図3(c))。なお、ここでは、有機金属溶液の塗布法を挙げて説明したが、導電性膜4の形成法はこれに限られるものでなく、真空蒸着法、スパッタ法、化学的気相堆積法、分散塗布法、ディッピング法、スピンナ法等を用いることもでき、インクジェット法等により直接パターニングを行うこともできる。

1 4

【0049】(3) 続いて、フォーミング工程を施す。 このフォーミング工程の方法の一例として、図6の真空 容器内での通電処理による方法を説明する。 図6におい て、55は真空容器であり、ゲートバルブ57を通じて ターボ分子ポンプ、スパッタイオンポンプ、クライオポ ンプなどからなる真空ポンプ56により排気される。な お、必要に応じてスクロールポンプ、ロータリポンプ、 ソープションポンプ等からなる補助ポンプが設けられる 場合もある。58は以降で説明する活性化工程で用いる 活性化ガスを収容する容器であり、バリアブルリークバ ルブやニードルバルブ等のスローリークバルブからなる 調節バルブ59を通じて真空容器55に接続している。 素子電極2および3には、電圧印加手段を接続する。例 えば、図6に示すように、素子電極2をグランド電位に 接続し、素子電極3を電流導入端子を通じて電源51に 接続する。なお、素子電極2、3間を流れる電流値をモ ニタするために電流計50を設ける。54はこの後の工 程で用いられるアノード電極であり、電流計52を通じ て高圧電源53に接続している。

20 【0050】フォーミングは、真空容器55内を排気し、素子電極2、3間に、電源51を用いて通電することにより行う。これにより、導電性膜4の部位に、構造の変化した電子放出部5が形成される(図3(c))。この通電フォーミングによれば導電性膜4に局所的に破壊、変形もしくは変質等の構造の変化した部位である電子放出部5が形成される。

【0051】 通電フォーミングにおいて印加する電圧波 形の例を図4に示す。同図に示すように、電圧波形はパ ルス波形が好ましい。これにはパルス波高値を定電圧と したパルスを連続的に印加する図4(a)に示した手法 と、パルス波高値を増加させながら電圧パルスを印加す る図4(b)に示した手法がある。図4(a)における T1およびT2は電圧波形のパルス幅とパルス間隔であ る。通常T1は1μsec~10msec、T2は10 μ sec \sim 10msecの範囲で設定される。パルスの 波高値は、表面伝導型電子放出素子の形態に応じて適宜 選択される。このような条件のもとで、例えば、数秒~ 数十分間電圧を印加する。パルス波形は矩形波に限定さ れるものではなく、三角波などの所望の波形を採用する ことができる。 図4 (b) におけるT1およびT2は、 図4 (a) に示したのと同様とすることができる。 パル スの波高値は、例えば0.1Vステップ程度づつ増加さ せることができる。

【0052】通電フォーミング処理の終了は、例えば導電性膜2が局所的に破壊、変形することによって生じる抵抗値の変化を読み取ることによって判断することができる。例えば、パルス間隔T2中に、導電性膜2を局所的に破壊、変形しない程度の電圧を印加し、電流を測定して検知することができる。例えば0.1V程度の電圧50 印加により流れる案子電流を測定し、抵抗値を求めて、

1 MΩ以上の抵抗を示した時、通電フォーミングを終了 させる。

【0053】(4)フォーミングを終えた素子には活性 化工程と呼ばれる処理を施すのが好ましい。活性化工程 とは、この工程により、素子電流If、放出電流Ieが 著しく変化する工程である。活性化工程は、例えば、有 機物質のガスを含有する雰囲気下で、通電フォーミング と同様に、パルスの印加を繰り返すことによって行うこ とができる。パルス電圧としては、図4 (a) に示した 圧パルスを用いることができる。活性化工程時の真空容 器内の雰囲気は、例えば油拡散ポンプやロータリポンプ などを用いて真空容器内を排気した場合に雰囲気内に残 留する有機ガスを利用して形成することができる他、イ オンボンプなどにより一旦十分に排気した真空中に適当 な有機物質のガスを導入することによっても得られる。 このときの好ましい有機物質のガス圧は、前述の応用の 形態、真空容器の形状や、有機物質の種類などにより異 なるため、場合に応じ適宜設定される。

ン、アルキンの脂肪族炭化水素類、芳香族炭化水素類、 アルコール類、アルデヒド類、ケトン類、アミン類、フ ェノール、カルボン、スルホン酸等の有機酸類等を挙げ ることができる。具体的にはメタン、エタン、プロパン 等の飽和炭化水素、エチレン、プロピレン等の不飽和炭 化水素、ブタジエン、n-ヘキサン、1-ヘキセン、ベ ンゼン、トルエン、ローキシレン、ベンゾニトリル、ト ルニトリル、クロロエチレン、トリクロロエチレン、メ タノール、エタノール、イソプロパノール、ホルムアル デヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メチルエチルケ 30 トン、ジエチルケトン、メチルアミン、エチルアミン、 酢酸、プロピオン酸等あるいはこれらの混合物が使用で きる。

【0055】活性化の処理により、雰囲気中に存在する 有機物質から、炭素あるいは炭素化合物が素子上に堆積 し、素子電流 I f および放出電流 I e が著しく変化する ようになる。活性化工程の終了判定は、素子電流 I fや 放出電流Ieを測定しながら適宜行う。なお、パルス 幅、パルス間隔、パルス波高値などは適宜設定される。 (5) このような工程を経て得られた電子放出素子に対 40 して、安定化工程を行うことが好ましい。この工程は、 真空容器内の有機物質を排気する工程である。真空容器 を排気する真空排気装置は、装置から発生するオイル等 の有機物質が素子の特性に影響を与えないように、オイ ルを使用しないものを用いるのが好ましい。具体的に は、磁気浮上型ターボ分子ポンプ、クライオポンプ、ソ ープションボンプ、イオンボンブ等の真空排気装置を挙 げることができる。

【0056】前記活性化の工程において、排気装置とし て油拡散ポンプやロータリーポンプを用い、そこから発 50 ことによって、基板1上に、図3 (a)に示すような素

生するオイル成分に由来する有機ガスを用いた場合は、 この成分の分圧を極力低く抑える必要がある。真空容器 内の有機成分の分圧は、上記の炭素および炭素化合物が ほぼ新たに堆積しない分圧であって1×10-6 Pa以下 が好ましく、さらには1×10-8Pa以下が特に好まし い。さらに真空容器内を排気するときには、真空容器全 体を加熱して、真空容器内壁や、電子放出素子に吸着し た有機物質分子を排気しやすくするのが好ましい。この ときの加熱条件は、80~250℃、好ましくは150 ような電圧パルスの他に、図5に示すような両極性の電 10 ℃以上であり、できるだけ長時間処理するのが望ましい が、特にこの条件に限るものではなく、真空容器の大き さや形状、電子放出素子の構成などの諸条件により適宜 選ばれる条件により行う。真空容器内の圧力は極力低く することが必要であり、1×10⁻⁵ Pa以下が好まし く、さらに1×10-6Pa以下が特に好ましい。

【0057】安定化工程を行った後の、駆動時の雰囲気 は、上記安定化処理終了時の雰囲気を維持するのが好ま しいが、これに限るものではなく、有機物質が十分除去 されていれば、真空容器の圧力は多少上昇しても、ある 【0054】適当な有機物質としてはアルカン、アルケ 20 程度安定な特性を維持することができる。このような真 空雰囲気を採用することにより、新たな炭素あるいは炭 素化合物の堆積を抑制でき、また真空容器や基板などに 吸着したH2O、O2なども除去でき、結果として素子電 流 I f および放出電流 I e が安定する。

> 【0058】(6)上記安定化工程を行った後、通常の 駆動を行う前に、素子電極2、3間に先述した予備駆動 電圧パルスを印加する予備駆動工程を行う。

【0059】以上により、本発明が適用可能な表面伝導 型電子放出素子の製造工程を終了する。完成した電子放 出素子に対して、素子電極2、3間に、予備駆動工程で 印加したVmax以下の駆動電圧Vdrvを印加し、電 子放出素子の上方に配置したアノード電極54に高圧電 源53を用いて高電圧を印加することによって、安定し た電子放出を得ることができる。

[0060]

【実施例】以下に、具体的な実施例を挙げて本発明を説 明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものでは なく、本発明の目的が達成される範囲内で、各要素の置 換えや設計変更がなされたものを包含するものである。 【0061】 [実施例1] 本実施例は、図2に模式的に 示したものと同様の構成を有する表面伝導型電子放出素 子に対して、本発明の製造方法を適用した例である。図 3に従い、本実施例を説明する。

【0062】まず、石英基板からなる基板1の洗浄後、 スパッタ法により基板1上に5nmのTiと50nmの Ptを堆積させた。そして、この堆積膜上にフォトレジ ストを塗布し、索子電極対2ならびに3に対応する形状 のパターンを形成してから、エッチングにより不要な部 分のPtとTiを除去し、そして、レジストを除去する

子電極2、3を形成した。なお、素子電極2、3間の間 隔Lは3μm、素子電極2、3の長さWは500μmと した。

17

【0063】次に、素子電極2、3を設けた基板1上 に、真空蒸着により厚さ50nmのCrを堆積させ、こ のCr膜に対して、フォトリソグラフィ技術を用いて、 導電性膜を形成する位置に対応した開口部を形成した。 その後、有機Pd化合物の溶液(ccp-4230:奥 野製薬(株)製)を塗布し、大気中で300℃の加熱処 理をした。そして、Cr膜をウエットエッチにより除去 10 し、純水で洗浄し、乾燥させることにより、図3(b) に示すような導電性膜4を形成した。

【0064】次に、以降の工程を行うために、図6に示 すように、製造工程中の電子放出素子を真空容器55内 に配置して電気的接続を行った。すなわち、素子電極2 はグランド電位に接続し、素子電極3は電流導入端子を 通じて電流計50ならびに素子電圧電源51に接続し、 また、基板1の5mm上方にアノード電極54を配置 し、アノード電極54は電流導入端子を通じて電流計5 2ならびに高圧電源53に接続した。

【0065】次に、真空容器55内を、スクロールポン ア (不図示) ならびに磁気浮上型ターボ分子ポンプ56 を用いて、1×10-3Pa以下の程度まで排気した後、 素子電圧電源51で発生させた電圧を素子電極3に印加 し、フォーミング処理を施して電子放出部5を形成し た。印加した電圧は、図4(b)に示すようなパルス状 の電圧とし、時間の経過とともに波高値の漸増するパル スとした。パルス幅T1は1msecとし、パルス間隔 T2は16.7msecとした。フォーミング処理中、 パルス波高値が5 Vに達した時点で電流計50を流れる 30 電子放出特性が得られた。 電流値が激減した。その後、パルス波高値が5.5Vに なるまでパルス電圧を印加してから、電圧の印加を停止 し、素子電極2、3間の抵抗値を測定した。その結果、 1ΜΩ以上の値を示したため、フォーミング処理を終了 した。この工程により導電性膜に間隙部(電子放出部) が形成される。

【0066】次に、真空容器55内の排気をさらに継続 し、容器内圧力が10-6Pa以下まで減少した後、スロ ーリークバルブ59を調節して、活性化ガス収容容器5 8から真空容器55内にベンゾニトリルガスを導入して 40 活性化工程を行った。活性化工程は、活性化ガスを導入 した真空容器55内の圧力が10-4Paになるように調 節し、素子電圧電源51で発生させた電圧を素子電極3 に印加することによって行った。印加した電圧は図5に 示すような両極性のパルス状の電圧であり、波高値Vf pとVfnの絶対値が等しい一定のパルスである。パル ス波高値は16Vとし、パルス幅T3は1msecと し、パルス間隔T4は16.7msecとした。活性化 処理は1時間行い、その後、電圧の印加を停止し、活性 化ガスの導入を停止して、真空容器55内から活性化ガ 50 計は60secであった。その後、素子電圧VfをVd

スを排気した。

【0067】次に、不図示のヒータを用いて真空容器5 5全体ならびに電子放出素子を一旦250℃に10時間 加熱し、さらに排気を推続することによって、その後の 室温時における真空容器内圧力を1×10-8Pa程度ま で低下させた。

【0068】このように真空容器内圧力を調整した後、 本発明の製造方法の特徴である予備駆動を行った。予備 駆動時のパルス電圧波形を図1に示す。 図1中の電圧値 Vdrvは15V、Vmaxは16Vである。すなわ ち、正極性パルス電圧の波高値を16V、逆極性パルス の波高値を-16Vとし、両者のパルス幅は100μs ecとし、正極性パルスと逆極性パルスのパルス間隔は 100msecとして、正極性パルス電圧を5発印加す ることにより、予備駆動を行った。その後、素子電圧V $f \in V d r v (= 15 V)$ に設定して駆動を行った。 【0069】一方、比較例として、全く同様の製法で作 成した電子放出素子に対し、予備駆動を行わずに最初か ら駆動電圧を15Vに設定して駆動を行った。本実施例 20 の素子と比較したところ、予備駆動を行った本実施例の 素子は、予備駆動を行わなかった比較例の素子に比べ て、駆動中の放出電流ならびに素子電流の減少と変動が 少なく、安定な電子放出特性が得られた。

【0070】また、本実施例および比較例の電子放出素 子に対し、駆動途中に波高値-10Vの逆極性電圧パル スを故意に印加し、その後、再度素子電圧を15Vとし て駆動を行った。この結果、予備駆動を行った本実施例 の素子は、予備駆動を行わなかった比較例の素子に比べ て、放出電流ならびに素子電流の減少が少なく、安定な

【0071】さらに、本実施例および比較例の電子放出 素子について、駆動中における素子電流の電気特性から 放出領域αと電界換算係数βを観測したところ、予備駆 動を行った本実施例の電子放出素子は、駆動期間内にお いて両者とも変動が少なく、安定しており、とりわけ放 出領域αの安定性が、予備駆動を行わなかった比較例の 電子放出素子に比べて優れていた。

【0072】 [実施例2] 活性化工程で印加するパルス 電圧の波高値を15Vとし、また、予備駆動の方法を異 なるものとした以外は実施例1と同様にして電子放出索 子の作成および駆動を行った。図11は本実施例で適用 した予備駆動のパルス電圧波形を示す。同図中の正極性 パルス電圧の波高値Vmaxは16V、パルス幅は1m sec、パルス間隔は10msecとした。また、逆極 性パルス電圧の波高値-Vmaxは-15.5V、パル ス幅は1msec、パルス間隔は10msecとした。 本実施例では、この正極性パルスと逆極性パルスを交互 に印加して予備駆動を行った。印加した正極性パルス電 圧は合計60000発、このバルス電圧の印加時間の合

2.0

rv(=15V)に設定して駆動を行った。

【0073】一方、比較例として、全く同様の製法で作成した電子放出素子に対して、予備駆動を行わずに最初から駆動電圧を15Vに設定して駆動を行い、また実施例1と同様、駆動途中に逆極性の電圧印加も行った。この結果、予備駆動を行った本実施例の素子は、予備駆動を行わなかった比較例の素子に比べて、駆動中の放出電流ならびに素子電流の減少と変動が少なく、安定な電子放出特性が得られた。

【0074】さらに、本実施例および比較例の電子放出 10 素子について、駆動中の素子電流の電気特性から放出領 域αと電界換算係数βを観測したところ、本実施例の電 子放出素子は、駆動期間内において、両者とも変動が少 なく安定しており、とりわけ放出領域αの安定性が、比 較例の電子放出素子に比べ優れていた。

【0075】[実施例3]活性化工程で印加するパルス 電圧の波高値を15Vとし、また、予備駆動の方法を異 なるものとした以外は実施例1と同様にして電子放出素 子の作成および駆動を行った。図10は本実施例で適用 した予備駆動のパルス電圧波形を示す。すなわち、本実 20 施例では、正極性パルス電圧と逆極性パルス電圧を交互 に繰り返し印加するのではなく、正極性パルス電圧を1. 0発印加した後、逆極性パルス電圧を1発印加するとい う工程を繰り返すことによって予備駆動を行った。図1 0中の正極性パルス電圧の波高値Vmaxは16V、パ ルス幅は1msec、パルス間隔は10msecとし た。また、逆極性パルス電圧の波高値-Vmaxは-1 5.5V、パルス幅は1msec、パルス間隔は10m secとした。また、印加した正極性パルス電圧は合計 60000発であり、このパルス電圧の印加時間の合計 30 を示す図である。 は60secであった。その後、素子電圧VfをVdr v (=15V) に設定して駆動を行った。一方、比較例 として、全く同様の製法で作成した電子放出素子に対し て、予備駆動を行わずに最初から駆動電圧を15Vに設 定して駆動を行い、また実施例1と同様に、駆動途中に 逆極性の電圧印加も行った。

【0076】この結果、予備駆動を行った本実施例の素子は、予備駆動を行わなかった比較例の素子に比べて、 駆動中の放出電流ならびに素子電流の減少と変動が少なく、安定な電子放出特性が得られた。

【0077】さらに、本実施例および比較例の電子放出 素子について、電子放出素子の駆動中における素子電流 の電気特性から放出領域 a と電界換算係数 B を観測した ところ、実施例の電子放出素子は、駆動期間内におい て、両者とも変動が少なく安定しており、とりわけ放出 領域αの安定性が、比較例の電子放出素子に比べて優れていた。

【0078】以上の実施例によれば、通常の駆動時に印加するパルス電圧の波高値より大きい波高値の正極性のパルス電圧を印加するとともに、通常の駆動時とは逆極性のパルス電圧を印加するようにしたため、電子放出素子からの放出電流を、長期に渡り安定させることができる。

[0079]

【発明の効果】本発明によれば、好適な電子放出素子の 製造方法、調整方法を実現することができる。また、好 適な電子放出素子の製造装置を実現することができる。 また、好適な電子放出素子の駆動方法を実現することが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明で使用できる電圧バルスの例を示す図である。

【図2】 本発明が適用可能な電子放出素子を示す概略 平面図ならびに概略断面図である。

0 【図3】 本発明が適用可能な電子放出素子の製造工程を示す図である。

【図4】 本発明が適用可能な電子放出素子のフォーミング工程中に使用する電圧パルスを示す図である。

【図5】 本発明が適用可能な電子放出素子の活性化工程中に使用する電圧パルスを示す図である。

【図6】 本発明が適用可能な電子放出素子の製造ならびに電気特性の測定に使用する真空装置ならびに駆動および測定装置を示す図である。

【図7】 本発明が適用可能な電子放出素子の電気特性)を示す図である。

【図8】 本発明が適用可能な電子放出素子の電気特性を示す図である。

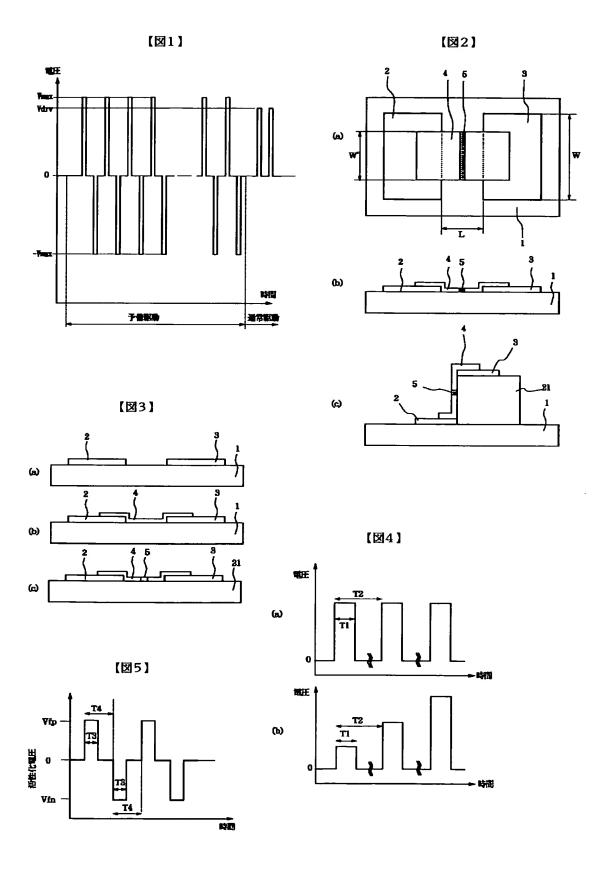
【図9】 本発明が適用可能な電子放出素子のメモリ特性を説明する図である。

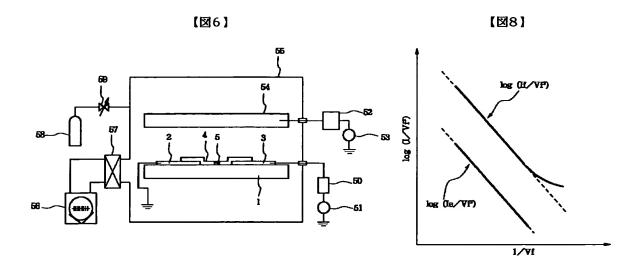
【図10】 本発明の製造方法で使用できる電圧バルスの他の例を示す図である。

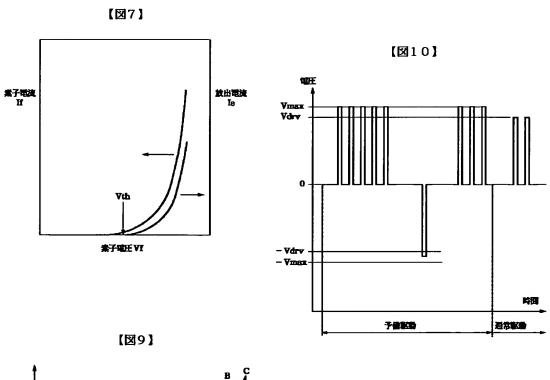
【図11】 本発明の製造方法で使用できる電圧パルスの他の例を示す図である。

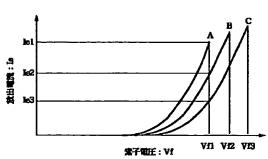
【符号の説明】

0 1:基板、2,3:素子電極、4:導電性膜、5:電子放出部、21:段差形成部、50:電流計、51:電源、52:電流計、53:高圧電源、54:アノード電極、55:真空容器、56:真空ボンプ、57:ゲートバルブ、58:活性化ガス収容容器、59:スローリークバルブ。









【図11】

